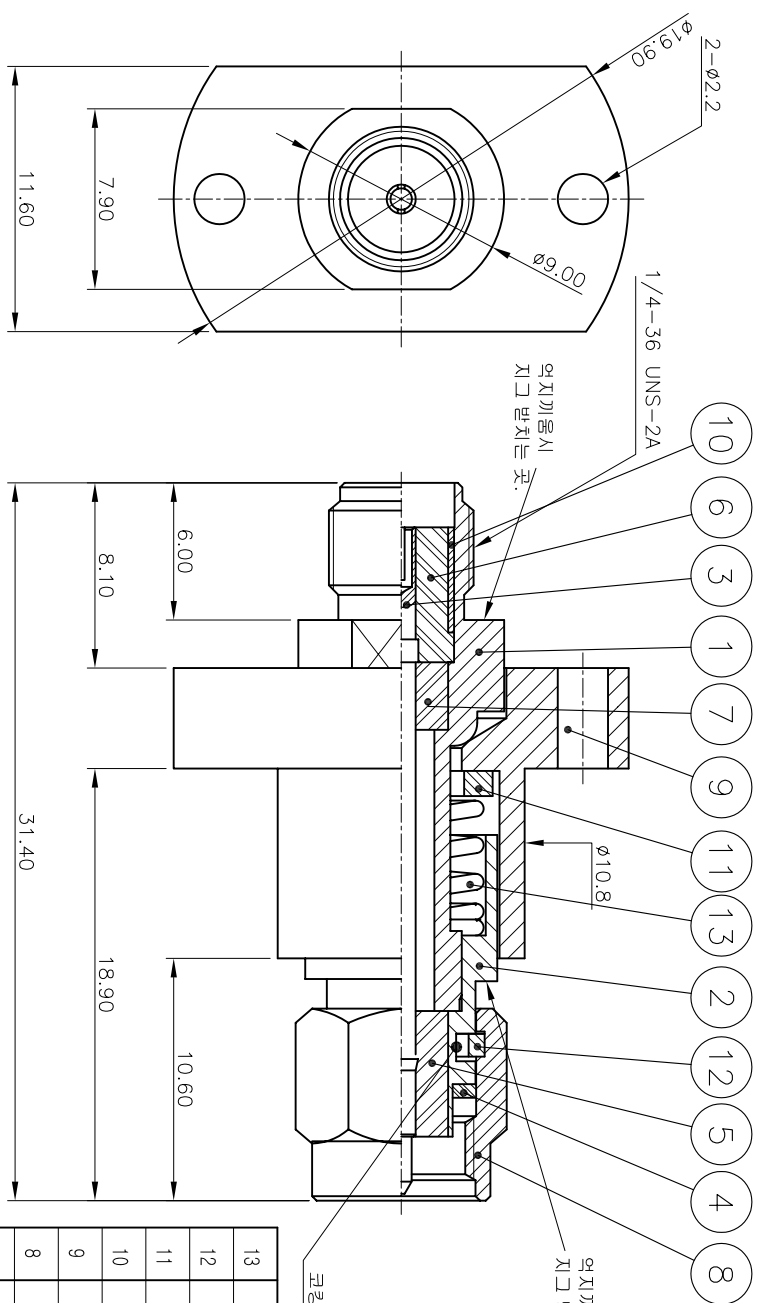


REVISION			DATE
REV	DESCRIPTION		
1	최초 개정	2006. 09. 25.	



* 전기적 특성

1. IMPEDANCE : 50 Ω NOMINAL
2. FREQUENCY RANGE : DC ~ 6GHz
3. Return Loss : -30dB(Max)
4. Insertion Loss : -0.3dB (Min)

- *조립 순서**
- 1) 1번 BODY에 7번 TEFLON을 조립한다.
 - 2) 9번 BODY COVER에 11번 INSET, 13번 SPRING을 넣은 후, 1번 BODY와 2번 BODY를 역지끼움 조립 한다. (지그 포인트 확인)
 - 3) 6번 TEFLON을 10번 COVER와 조립 후 3번 PIN과 함께 위의 조립한 BODY에 넣고 역지끼움 조립한다.
 - 4) 5번 TEFLON을 넣고 코킹을 한다.
 - 5) SMA GASKET, RING을 넣고 CAP을 조립한다.

NO.		DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE
13	1	SPRING	1	SUS304		DSR01048-N/1 (RF113)
12	1	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1 (R2001)
11	1	INSERT	1	MBSBD	Nickel Plate	DIS00107-5/1 (M2019)
10	1	COVER	1	MBSBD	Nickel Plate	DIS00106-5/1 (L2041)
9	1	BODY COVER	1	MBSBD	Nickel Plate	DCU00042-5/1 (L2040)
8	1	COUPLING CAP	1	MBSBD	Nickel Plate	DCU00005-5/2 (K2011)
7	1	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01113-N/1 (H2352)
6	1	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01114-N/1 (H2351)
5	1	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN00173-N/1 (H2306)
4	1	GASKET	1	SILICONE RUB	Red	DGK00004-N/1 (G2001)
3	1	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00089-5/1 (E2530)
2	1	BODY-B	1	MBSBD	Nickel Plate	DBD01659-5/1 (D2512B)
1	1	BODY-A	1	MBSBD	Nickel Plate	DBD01660-5/1 (D2512A)

DATE		2006. 09. 25.	TITLE		SMA50-H2-A-JP(SPRING)
APPROVED BY		S.J.YOUN	DWG NO.		AD00176-7/1 (K314-707-000)
CHECKED BY		I.C.KIM	REVISION		1
DRAWN BY		E.H.KIM	SHEET		1 of 1
SCALE		3/1	UNIT		mm
FINISH		-	TOLERANCE		Decimal Angle $\pm 0.1^\circ$
MATERIAL		-	DRAWN BY		E.H.KIM

KU COMTECH
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017